



# 第 25 届电子封装技术国际会议

2024年8月7-9日 中国·天津

<http://www.icept.org>

**演讲题目:** 面向医疗健康与机器人领域应用的柔性混合

**演讲人:** 吴豪 教授 华中科技大学

## 演讲人简介:

吴豪，华中科技大学机械学院教授、博士生导师，华中科技大学集成电路学院双聘教授。2007 年从华中科技大学机械设计制造及其自动化专业获得学士学位，2012 年从美国佐治亚理工学院机械工程系获得博士学位，之后在美国英特尔公司电子封装测试技术研发部担任工艺研发高级工程师。2016 年 6 月回到华中科技大学从事教学科研工作，主要研究领域为先进电子制造工艺与装备，具体研究方向包括柔性电子器件与系统集成，先进电子封装技术。发表学术论文六十余篇，其中回校工作后以通讯作者在 *Science Translational Medicine*, *Advanced Materials* 等相关领域权威期刊发表论文四十余篇，研究成果多次被科技媒体亮点报道。担任知名期刊 *Precision Engineering*, *National Science Open* 副主编，入选国家海外高层次人才计划，获得制造工程师学会杰出青年制造工程师奖(SME OYME)等奖励。